

特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

代理人
武政 善昭

様

あて名
〒108-0073
日本国東京都港区三田3丁目4番3号 三田第一長
岡ビル8F

PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
〔PCT規則43の2.1〕

14. 6. 2005

発送日
(日.月.年)

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

出願人又は代理人
の書類記号 PCT413-2005-

国際出願番号 PCT/JP2005/008588	国際出願日 (日.月.年) 11.05.2005	優先日 (日.月.年)
-----------------------------	-----------------------------	----------------

国際特許分類 (IPC) IntCl. 7 C08J7/00 // C08L101:00

出願人 (氏名又は名称)
柿原工業株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- 第I欄 見解の基礎
- 第II欄 優先権
- 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第IV欄 発明の単一性の欠如
- 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- 第VI欄 ある種の引用文献
- 第VII欄 国際出願の不備
- 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

25.05.2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

森川 聰

4 J 9268

電話番号 03-3581-1101 内線 3457

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、
以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ 配列表

配列表に関連するテーブル

b. フォーマット 書面

コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 出願時の国際出願に含まれる

この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 3-6, 8, 9 請求の範囲 1, 2, 7, 10	有 無
進歩性 (I S)	請求の範囲 3-6, 8, 9 請求の範囲 1, 2, 7, 10	有 無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 1-10 請求の範囲	有 無

2. 文献及び説明

文献1: J P 7-118416 A (出光マテリアル株式会社) 1995. 05.
09

請求の範囲1、2、7及び10

請求の範囲1、2、7及び10に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に記載されているから新規性を有しない。

請求の範囲3-6、8及び9

請求の範囲3-6、8及び9に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1に対して進歩性を有する。

文献1には、樹脂成形品を表面におけるゴム粒子が略円形状を保つように高温加熱処理すること、樹脂成形品のパーティングライン部分を高温加熱処理すること、樹脂成形品の樹脂表層薄膜剥離が予想される特定の部位を高温加熱処理すること、A B S樹脂製の樹脂成形品について表面温度が80~150°Cになる加熱温度範囲内で高温加熱処理すること、P C / A B S樹脂製の樹脂成形品について表面温度が100~200°Cになる加熱温度範囲内で高温加熱処理することが記載されておらず、一方、本願発明はそれにより、樹脂成形品の表層薄膜の浮き上がりによる金属めっき膜が樹脂薄膜と一緒に剥離する現象が抑制されるように樹脂めっきすることができるという有利な効果を発揮する。

2. Document and Description

Document 1: JP 7-118416 A (Idemitsu Material Co.) 1995.05.09

Claims 1, 2, 7 and 10

The inventions described in claims 1, 2, 7, and 10 are described in the Document 1 cited in the International Search Report and, accordingly, have no novelty.

Claims 3 to 6, 8 and 9

The inventions described in claims 3 to 6, 8 and 9 have progressiveness to the Document 1 cited in the International Search Report

The Document 1 does not describe a high-temperature heat treatment for maintaining a substantially circular shape of a rubber particle at the surface of the resin molding, a high-temperature heat treatment for the parting line portion of the resin molding, a high-temperature heat treatment for a specific portion of the resin molding which portion is apt to undergo peeling of a thin surface resin film, a high-temperature heat treatment within a range of the heating temperature to render the surface temperature of the resin molding made of ABS resin to 80 to 150°C, and a high-temperature heat treatment within the range of the heating

temperature to render the surface temperature of the resin molding made of PC/ABS resin to 100 to 200°C. On the other hand, the present invention provides an advantageous effect obtained thereby capable of conducting resin plating so as to suppress the phenomenon that the metal plating film is peeled off together with the thin resin film caused by the raising of the surface layer thin film of the resin molding.